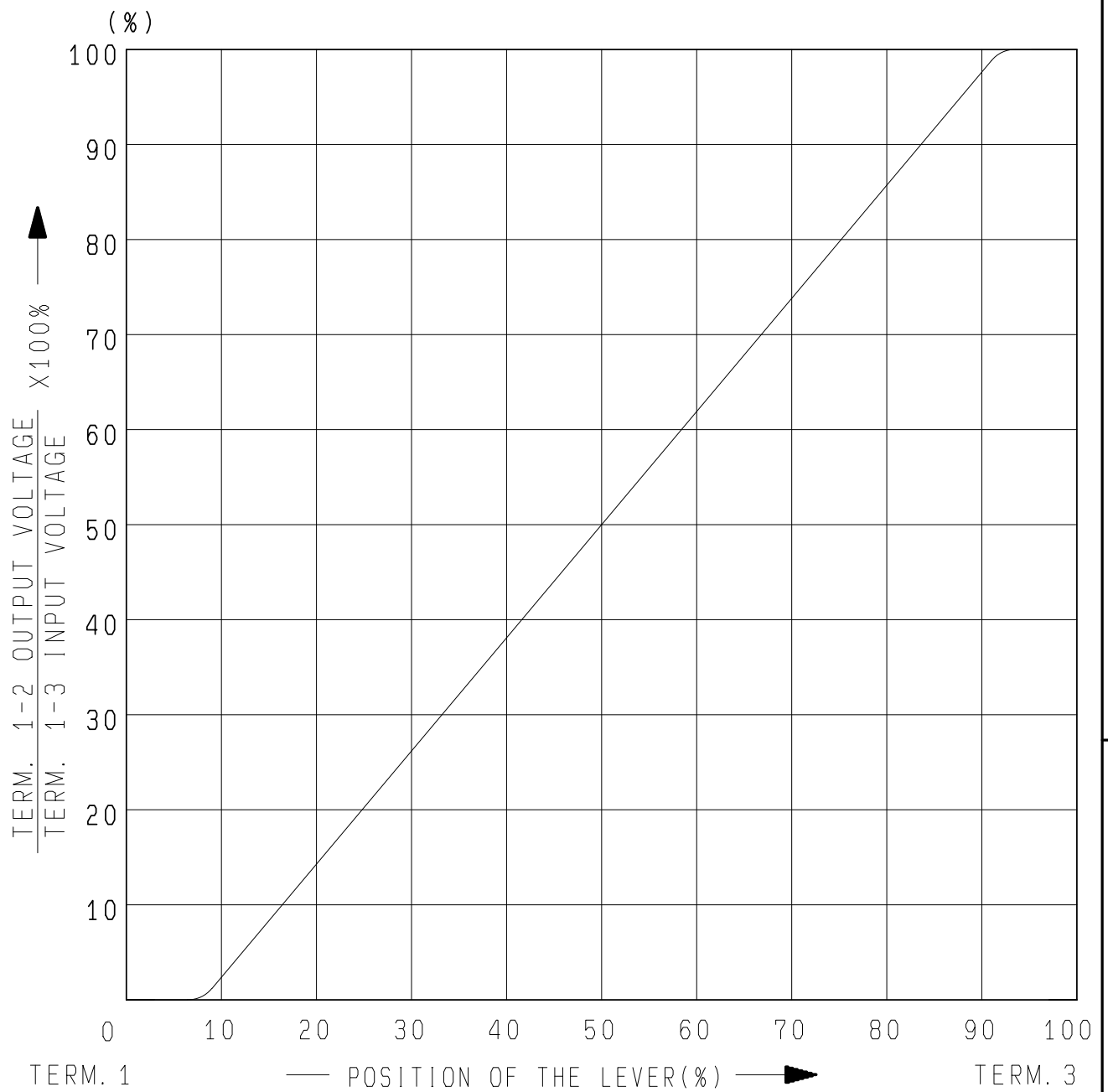




AT 50% TRAVEL FROM TERM. 1 VOLTAGE PERCENT SHALL FALL
WITHIN THE LIMITS OF 40~60 PERCENT.

					APPD.	CHKD.	DSGD.	NAME 30mm TRAVEL TYPE B
					Apr. 01, '96		Apr. 01, '96	RESISTANCE TAPER
					S. Sasaki		K. Matsukawa	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				RS30H121A00B (3/3)

ご使用上の注意

PRECAUTION IN USE

1. 偏心ツマミをご使用になる場合

レハ[＊]の中心より離れたところを作用点としてご使用になる場合、可能な限り
下図A寸法を短くしてご使用下さい。

If it will be used the operating point away from the center line of the lever, it should be shorter as possible.

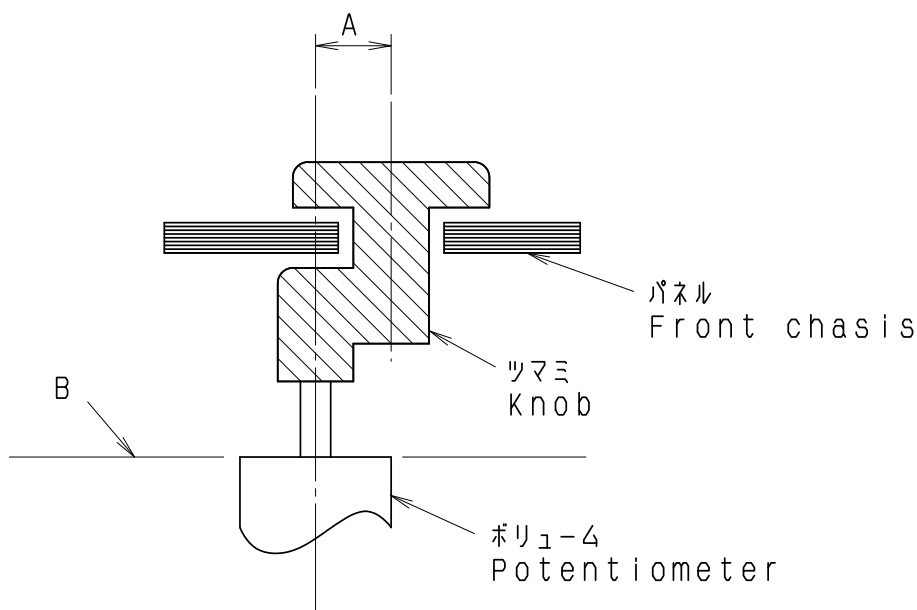
2. レハ[＊]ー長さについて

レハ[＊]ー長さについては、ツマミを含めて、下図B面より極力短いものを
ご使用願います。レハ[＊]ー長さについては、作用点までの距離が短いほど
しゅう動感触が良好となり、長いほど好ましくない感触になります。

About the length of lever

If conditions permit, it is advisable to use the shortest possible lever.

The longer the length up to operating point, the more unfavorable slide feeling will be given.



3. レハ[＊]ーの駆動に関しては上記内容を考慮の上、セット実装を行い

あらかじめ異常のないことをご確認願います。

Regarding the operation of the lever, please consider the above mentioned, and make sure nothing is wrong with the operation under installing in your appliance that you plan to use our products actually.

4. ツマミ挿入及びレハ[＊]ー操作は、ホ[＊]リウムマウント基板に

ソリ(曲がり)のない状態で行って下さい。

Knob assembly on the lever and functioning the lever to be performed under the condition of P.C.B. without warp.

					ALPSALPINE CO.,LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					PD1-ENG1	PD1-ENG1	PD1-ENG1	スライト [＊] ホ [＊] リウム 仕様書
					'95.7.24	'95.7.24	'95.7.24	SPECIFICATIONS
					YOSIOKA	KIMURA	Y.SAITOH	DOCUMENT NO.
ORIGINAL	'91-7-3	Y・Y	K・N	S・A	450001-200			
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

はんだ付け条件

FOLLOW THE NEXT CONDITIONS FOR SOLDERING

1. はんだ SOLDER

JIS Z 3282に規定のA30C5はんだを使用

A30C5 solder specified in JIS Z 3282.

2. 使用基板 BOARD IN USE

両面スルーホール基板又は、片面銅張積層板 板厚 $t=1.6\text{mm}$

Double-faces through-hole board or Single-face copper laid laminate board.

Plate thickness (t)= 1.6mm

3. 自動はんだ<DIP条件>

(1) レハ" - 位置 センター付近に設定願います。

(2) フラックス比重 0.83 ± 0.01 (発泡式)

(3) フラックス高さ フ" リント基板の板厚の半分の位置にフラックスの上面が接するレハ" ル (図1)
又、ホ" リューム挿入面への流れ込みのないこと。(フラックス上がり、飛散に注意)

(4) フ" リヒート温度 100°C max. 時間1分以内。(フ" リント基板のホ" リューム挿入側の温度)

(5) はんだ温度 260°C max. 時間5秒以内. はんだ回数は1回までとする。

IN THE CASE OF DIP SOLDERING

(1) State of potentiometer

Position a lever in the vicinity of center.

(2) Specific Gravity of Flux

0.83 ± 0.01 (foaming type)

(3) Height of Flux face

A level of the upper face of flux for reaching the position at a half of the plate thickness of printed board. (Fig. 1)

Further, no flow of flux invading on the surface of printed board on the side of installing potentiometer is allowed.

(4) Preheat condition

100°C max., within 1 minute

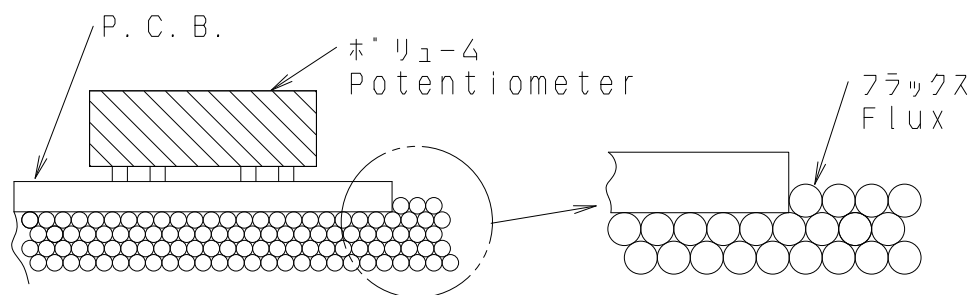
(Temperature on the side of installing printed board is designated.)

(5) Soldering condition

Solder temperature; 260°C max.

Soldering period ; within 5 seconds

Time of soldering ; only one time is permitted



(Fig. 1)

4. 手はんだ IN THE CASE OF MANUAL SOLDERING

はんだ温度 350°C max. 時間3秒以内 はんだ回数は1回までとする。

Solder temperature ; 350°C max.

Soldering period ; within 3 seconds

Time of soldering ; only one time is permitted

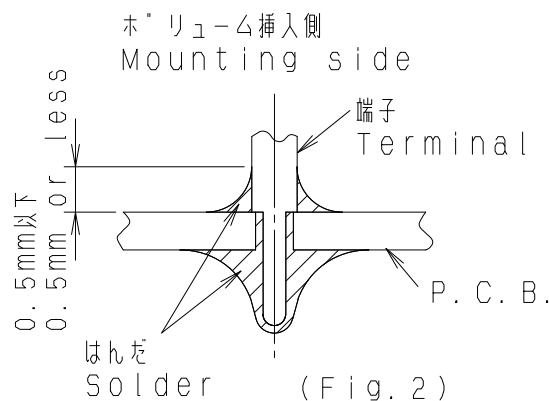
					ALPSALPINE CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					PD1-ENG1 '95.7.24 YOSIOKA	PD1-ENG1 '95.7.24 KIMURA	PD1-ENG1 '95.7.24 Y. SAITOH	スライト" ホ" リューム 仕様書 SPECIFICATIONS 1/2
ORIGINAL	'91-9-3	Y・Y	S・A	S・S	DOCUMENT NO.			
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	450001-201			

5. 注意事項

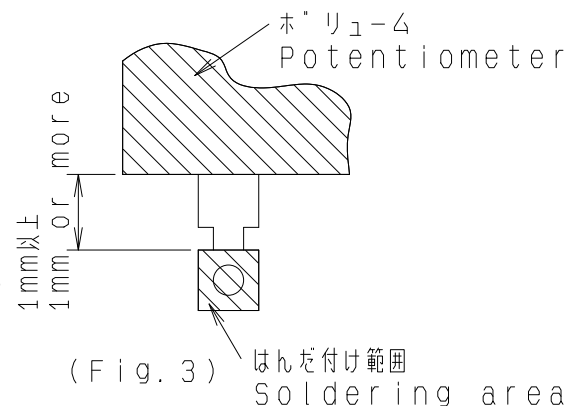
- (1) はんだ付けの際に、端子にストレスを加えないで下さい。例えば、端子に熱を加えたまま製品を動かしますと、かしめ力^{*} 及び電気的特性が劣化する恐れがあります。
- (2) 両面スルーホール基板を使用する場合は、ホ^{*} リューム挿入側の端子取付穴に、はんだランド^{*} がないようにご配慮願います。ホ^{*} リューム挿入側での配線が必要な場合は端子取付穴からの直接取り出しを避けスルーホール配線用の穴を設けるなどのご配慮をお願いします。
- (3) ホ^{*} リューム挿入側へのはんだ上がりは、はんだ熱による端子接触不良の発生原因となりますので(図2)を参照願います。
- (4) リート^{*} 配線の場合、ホ^{*} リューム本体と、はんだ付け部の距離を1mm以上開けてはんだ付け願います。(図3)
- (5) はんだ付けによるホ^{*} リュームへの影響は、フ^{*} リント基板の大きさ、ホ^{*} リュームの取付け位置、はんだ槽の大きさ、等により異なりますのであらかじめ実使用状態で実施し、異常のないことを確認の上、はんだ付けして下さい。

MATTERS TO BE NOTED

- (1) Do not add any stress on terminals in the case of soldering. For instance, forced movement of potentiometer with terminals being heated may probably deteriorate the electric features due to generation of looseness in connection between resistant board and terminals.
- (2) Avoid use of double-faces through-hole board as much as possible. If it is necessary to use it, Do not apply through-hole plating to a hole in which a potentiometer is inserted, and install a land to which terminals are soldered only on a face oppsite to the face on the side of installing potentiometer.
- (3) Use caution to soldering process so as to prevent solder from rising up to the surface of printed board on the side of installing potentiometer, because defective contact may take place in terminal connecting part due to soldering heat .(Fig.2)
- (4) In the case of lead wiring, solder it so that a gap of 1 mm or more may be reserved between the potentiometer body and soldering part.(Fig.3)
- (5) The grade of influence of soldering exerted on the potentiometer depends upon the size of a printed board, installing position of the potentiometer, and the size of a solder bath etc. Therefore, make sure, in advance, of no abnomal state under the conditions of soldering to be carried our at present.



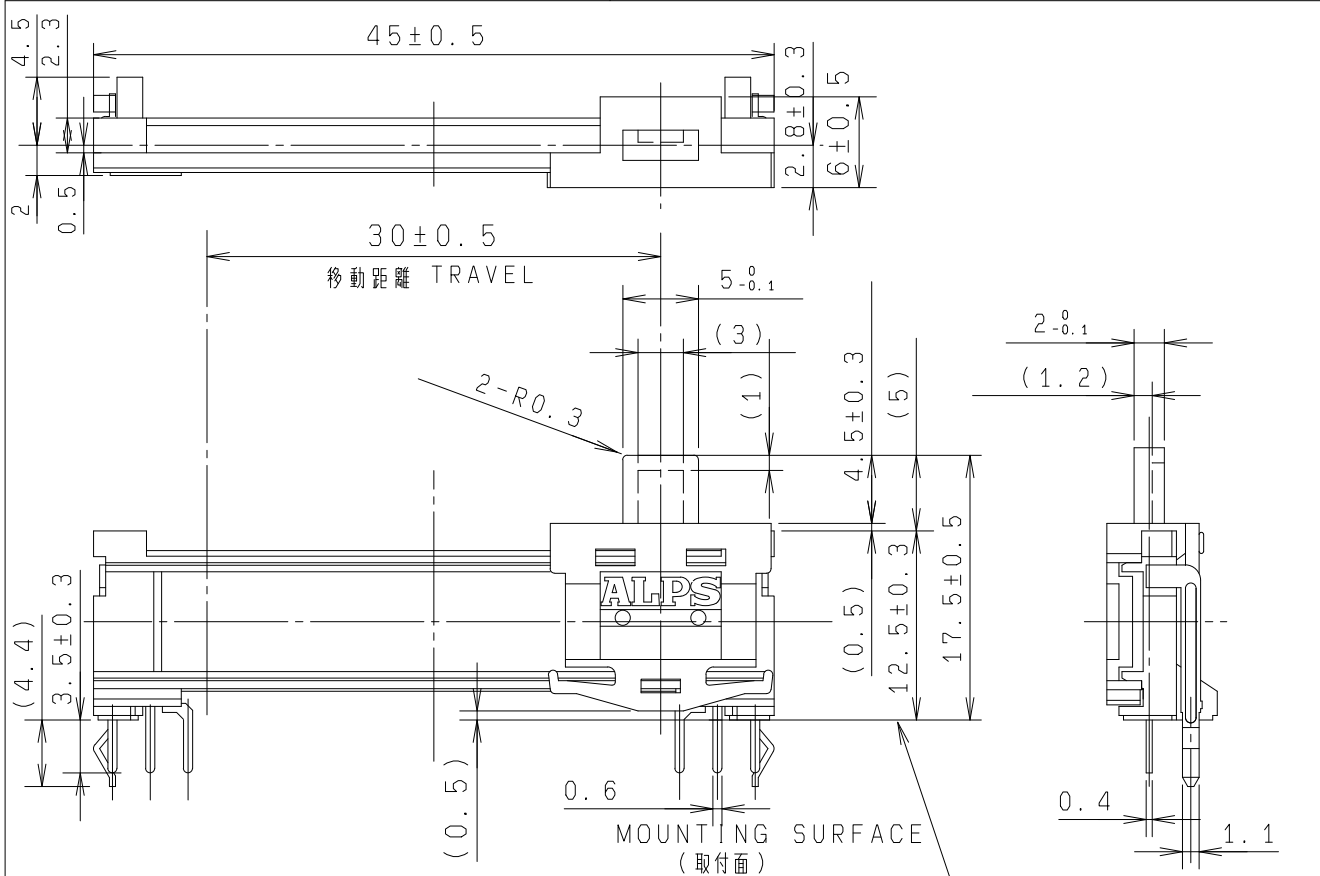
(Fig. 2)



(Fig. 3)

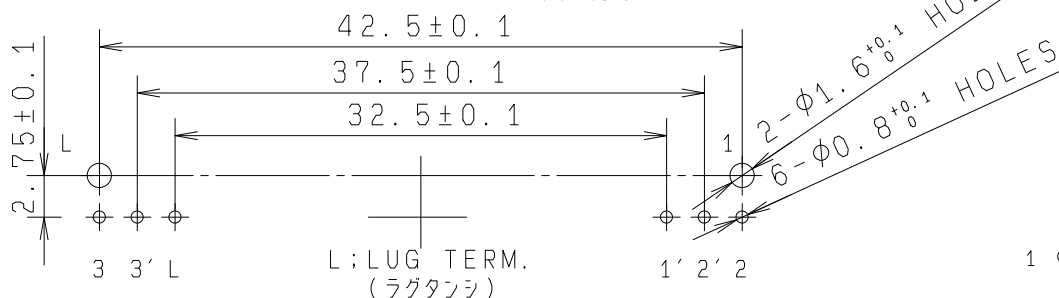
					ALPSALPINE CO.,LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	
					PD1-ENG1 '95.7.24 YOSIOKA	PD1-ENG1 '95.7.24 KIMURA	PD1-ENG1 '95.7.24 Y. SAITOH	スライト [*] ホ [*] リューム 仕様書 SPECIFICATIONS 2/2	
ORIGINAL	'91-9-3	Y・Y	S・A	S・S					DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					450001-201

RS15H1130B15



MOUNTING HOLE DETAIL (取付穴寸法図)

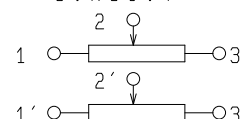
VIEWED FROM MOUNTING SIDE (挿入側より)



Note 1. Top side of knob shall be mounted to lever within 20mm length.
ツマミ長さは、レバー長さを含めて20mm以内でご使用願います。

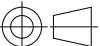
回路図

CIRCUIT



指定なき部分の許容差
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC

$L \leq 10$	± 0.3
$10 < L < 100$	± 0.5
$100 \leq L$	± 0.8
角度 ANGULAR DIMENSION	$\pm 5^\circ$

PART NO.		NAME			MATERIAL NAME / CODE			FINISH	
					ALPSALPINE CO.,LTD.				
					DSGD. セツケイ Y, WATANABE ' 92-06-08		SCALE 2 : 1	NO. RS30H121A0 RS30H121A00B	
					CHKD. K, SATOU ' 92-06-08			TITLE SLIDE POTENTIOMETER DUAL UNIT	
					APPD. Y, YOSHIOKA ' 92-06-08		UNIT mm	DOCUMENT NO. S2K-A112 S302KGA01	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					